

DAFTAR ISI

| | <i>Hal</i> |
|--|-------------|
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI..... | <i>i</i> |
| RIWAYAT HIDUP | <i>ii</i> |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS | <i>iii</i> |
| HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | <i>iv</i> |
| ABSTRAK | <i>v</i> |
| ABSTRACT | <i>vi</i> |
| KATA PENGANTAR | <i>vii</i> |
| DAFTAR ISI | <i>x</i> |
| DAFTAR GAMBAR | <i>xii</i> |
| DAFTAR TABEL | <i>xiii</i> |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | <i>xiv</i> |
| BAB I PENDAHULUAN | <i>1</i> |
| 1.1 Latar Belakang | <i>1</i> |
| 1.2 Ruang Lingkup Penelitian | <i>4</i> |
| 1.3 Batasan Masalah | <i>5</i> |
| 1.4 Rumusan Masalah | <i>5</i> |
| 1.5 Tujuan penelitian..... | <i>5</i> |
| 1.6 Manfaat Penelitian | <i>6</i> |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | <i>7</i> |
| 2.1 Logam Perak (Argentum / Ag) | <i>7</i> |
| 2.2 Logam Tembaga (Cuprum / Cu)..... | <i>8</i> |
| 2.3 Electroplating (Penyepuhan) Logam..... | <i>9</i> |
| 2.4 Faktor-Faktor yang mempengaruhi proses electroplating..... | <i>11</i> |
| 2.5 Proses electroplating | <i>13</i> |
| 2.6 Kerangka Berfikir | <i>15</i> |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | <i>17</i> |
| 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian..... | <i>17</i> |
| 3.2 Teknik Pengumpulan Data | <i>17</i> |
| 3.3 Instrument Penelitian | <i>19</i> |
| 3.3.1 Alat | <i>19</i> |

| | |
|---|----|
| 3.3.2 Bahan..... | 19 |
| 3.4 Prosedur Penelitian | 19 |
| 3.4.1 Preperasi Sampel..... | 19 |
| 3.4.2 Proses Electroplating | 19 |
| 3.4.3 Proses Karakteristik Logam Cu | 20 |
| 3.5 Bagan Alir Penelitian | 22 |
| 3.5.1 Pelapisan Logam | 22 |
| 3.5.2 Karakterisasi Logam Cu yang telah dilapisi..... | 23 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 24 |
| 4.1 Hasil Penelitian | 24 |
| 4.1.1 Preparasi Sampel..... | 24 |
| 4.1.2 Proses <i>Electroplating</i> | 24 |
| 4.1.3 Ketebalan Pelapisan..... | 33 |
| 4.2 Morfologi Permukaan Tembaga Pelapisan | 38 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 41 |
| 5.3Kesimpulan..... | 41 |
| 5.2 Saran..... | 41 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 42 |
| LAMPIRAN..... | 46 |